Referenten

Jürgen Gruber

RoodMicrotec GmbH, Stuttgart (D)

Björn Hoffmann

RoodMicrotec GmbH, Stuttgart (D)

Peter Jacob

Empa, Dübendorf (CH) / EM Microelectronic-Marin SA, Marin (CH)

Karim T. Kaschani

Texas Instruments Deutschland GmbH, Freising (D)

Christian Mohr

RoodMicrotec GmbH, Stuttgart (D)

Uwe Thiemann

EM Microelectronic-Marin SA, Marin (CH)

Titelbild

Nach EOS-Schädigung abgeschmolzene Bonddrähte in einem Halbleiterchip (Röntgenaufnahme)

Quelle: Peter Jacob, Empa

Veranstaltungshinweise

Veranstaltungsort **Siemens AG**
Weissacher Str. 11
70499 Stuttgart
Schulungsraum / 1. OG

Kosten **€ 680,00**
zzgl. Mehrwertsteuer
gemäß §3a Abs.3 Nr.5 UStG
inklusive Verpflegung und Seminarunterlagen
EMPA Pool-Mitglieder & Mitglieder von Strategische Partnerschaft Sensorik e.V. erhalten € 50,00 Ermäßigung

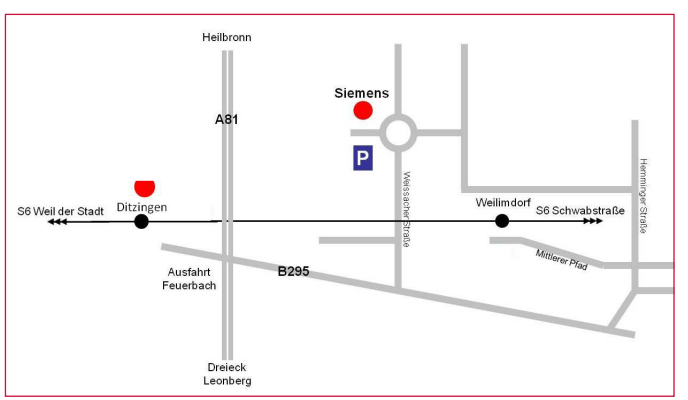
Anmeldung **seminar@roodmicrotec.com**

Anmeldeschluss **30. September 2019**

Teilnahme und Rücktrittsbedingungen

Die Teilnahmegebühr ist mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei Stornierung der Anmeldung nach dem 27.09.2019 werden 50% der Teilnahmegebühr fällig, nach dem 04.10.2019 oder bei Nichterscheinen 100%.

Auskunft RoodMicrotec GmbH
Herr Jürgen Gruber
Motorstr. 49, 70499 Stuttgart
Telefon: +49 711 86709 -62
E-Mail: juergen.gruber@roodmicrotec.com

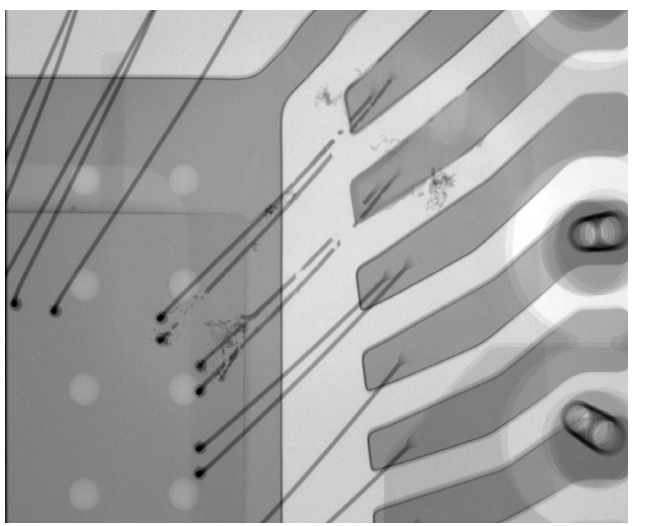


RoodMicrotec

Seminar

EOS (Electrical Overstress) - Was wirklich dahinter steckt

Definition, Ausfallursachen, Beispiele und methodische Lösungsansätze



Weissacher Str. 11, 70499 Stuttgart

Donnerstag, 10. Oktober 2019, 9:00 - 17:00 Uhr

Thematik

EOS (Electrical Overstress) steht in vielen Fällen am Ende von Ausfallanalyseberichten, ohne dass sich daraus ein Rückschluss über die tatsächliche Ausfallursache ableiten lässt.

Spöttische Ausfallanalytiker sprechen deshalb nicht ganz zu Unrecht bei EOS-Diagnosen auch von „End of Story“. Häufig ist auch von EOS/ESD die Rede, was meist aber eher zur Verwirrung als zur Ermittlung der wahren Ausfallursache beiträgt. Zudem zeigt dies, dass es schon die Definition in sich hat.

Das Seminar beleuchtet das Dickicht der Ausfälle mit einer EOS-Fehlersignatur und zeigt die Vielfalt der tatsächlichen Ursachen für EOS auf. Bei deren Ermittlung stößt die klassische Fehleranalyse auf Bauelemente-Ebene an ihre Grenzen und wird durch die Fehleranamnese, die auf der Systemebene ansetzt, sinnvoll ergänzt und erweitert.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Ausfallanalytiker auf allen Ebenen der modernen Elektronik sowie an Elektronik-entwickler und Testingenieure - auch hier vom Bauelement bis zum fertigen System.

Programm

09:00-09:30	Registrierung und Brezelfrühstück
09:30-09:45	Begrüßung *Jan de Koning Gans, Jürgen Gruber*
09:45-10:30	EOS (Teil 1): Definition und Ursachen *Karim T. Kaschani*
10:30-11:00	Kaffeepause
11:00-11:45	EOS (Teil 2): Bestimmung und Vermeidung *Karim T. Kaschani*
11:45-12:45	EOS: End of Story? - Eine Einführung in die Fehleranamnese *Peter Jacob*
12:45-13:45	Mittagessen
13:45-14:15	MOS (Mechanical Overstress) elektronischer Komponenten - im Kontext der zunehmenden Miniaturisierung der Elektronik betrachtet *Jürgen Gruber*
14:15-14:45	Fallbeispiele aus der Praxis - es muss nicht immer EOS sein *Christian Mohr*
14:45-15:10	Wie hängen ESD und EOS zusammen? *Peter Jacob*
15:10-15:40	Kaffeepause
15:40-16:00	Wie zeigt sich EOS bei LEDs? *Björn Hoffmann*
16:00-16:20	ESD-verursachter EOS in Folienprozessen bei der RFID-Chipkarten-Produktion *Uwe Thiemann*
16:20-16:40	Leistungshalbleiter-Device verbrannt - wie weiter? *Peter Jacob*
16:40-17:00	Kann man Robustness testen? Unkonventionelle EOS-Fehlerprovokationsansätze *Peter Jacob*
17:00-18:00	Schlusswort und anschließende Laborbesichtigung für Interessierte in Kleingruppen bei RoodMicrotec *Jürgen Gruber*

Anmeldung

EOS (Electrical Overstress) - Was wirklich dahinter steckt

Definition, Ausfallursachen, Beispiele und methodische Lösungsansätze

Weissacher Str. 11, 70499 Stuttgart

Donnerstag, 10. Oktober 2019, 9:00 - 17:00 Uhr

Anmeldeschluss: 30. September 2019

☐ Ja, ich nehme teil.

☐ Ich bin Mitglied von Strategische Partnerschaft Sensorik e.V.

☐ Ich bin EMPA Pool-Mitglied

Name _____ Vorname _____

Firma _____

Straße / Postfach _____

Telefon _____

E-Mail _____

RoodMicrotec KD-Nr. oder USt.IdNr. _____

Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie diesen Anmeldebogen per Email an:
seminar@roodmicrotec.com